

# SPIE High-Power Laser Ablation – HPLA 2024

大阪大学 産業科学研究所  
RONDEPIERRE ALEXANDRE (ロンドピエール アレクサンドル)  
(2023 年度 国際会議等参加助成 AF-2023247-Y1)

キーワード：レーザショックピーニング，プラズマ

## 1. 開催日時

2024 年 2 月 26 日～3 月 1 日

## 2. 開催場所

SANTA FE, NEW MEXICO, UNITED STATES (アメリカのニューメキシコのサンタフェ)

## 3. 国際会議報告

サンタフェの HPLA (SPIE High-Power Laser Ablation VIII) の学会は 100 人ぐらいの人がいました。

いっぱい面白い発表がありました。たとえば、アプリケーションについてはフェムト秒レーザプロセッシングかレーザプラズマ加速、レーザの慣性閉じ込め方式でした。もう一つはレーザショックのプロセスでした。この最後に私が発表しました。

私の発表は 2 月 29 日朝の 8 時半でした。私の発表は 23 分ぐらいかかりました。そして、5 人の人が質問をしました。後で (コーヒーの休憩) 3 人と話しました。彼らは私のレーザの新たな進歩の研究は良いと言いました。

他の発表は新しい高いパワーレーザシステムです。たとえば、ファイバーレーザやダイオードレーザです。パフォーマンスは本当に印象的でした。たくさんの事を学びました。

## 謝 辞

公益財団法人天田財団。細貝知直先生と佐野雄二先生。

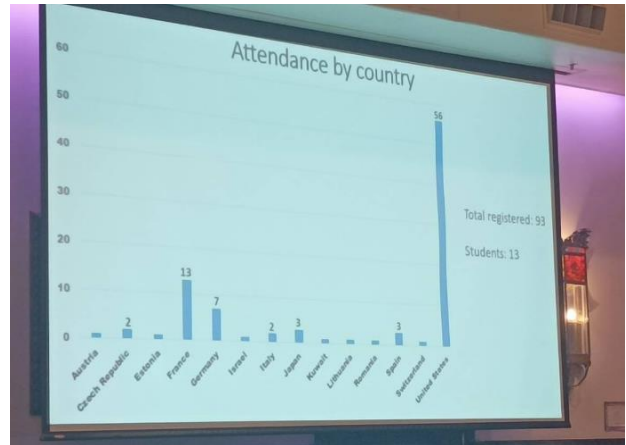


図 1. 参加者と参加国のまとめです。



図 2. 私の発表の時です。



図 3. レーザショックのコミュニティの写真です